

有研半导体硅材料股份公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告



对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2025)第 0111 号
(第一页, 共二页)

有研半导体硅材料股份公司董事会:

我们接受委托, 对有研半导体硅材料股份公司(以下简称“有研硅”)关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

有研硅管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》编制, 在所有重大方面如实反映了有研硅 2024 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2025)第 0111 号
(第二页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》编制,在所有重大方面如实反映了有研硅 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》编制,并在所有重大方面如实反映了有研硅 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供有研硅按照上述规定的要求在 2024 年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师


汪超
汪超(项目合伙人)中国·上海市
2025 年 3 月 27 日

注册会计师


张建隆
张 建 隆

有研半导体硅材料股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 6 日签发的证监许可[2022] 2047 号文《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》，有研半导体硅材料股份公司(以下简称“本公司”)向社会公众发行人民币普通股 187,143,158 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.91 元，募集资金总额为人民币 1,854,588,695.78 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,663,967,265.37 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 11 月 7 日到位，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具毕马威华振验第 2201588 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司以前年度已累计使用募集资金人民币 473,190,853.03 元，本年度使用募集资金人民币 527,372,766.60 元。募集资金余额为人民币 708,569,195.04 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，募集资金专项账户余额为人民币 158,569,195.04 元，与募集资金余额相差人民币 550,000,000.00 元均为未到期的现金管理余额。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金专项账户年初余额	259,585,963.98
减：本年度投入募集资金总额	527,372,766.60
减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	(2,955,006.37)
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	(400,000,000.00)
加：本年度对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	23,400,991.29
募集资金专项账户年末余额	158,569,195.04

有研半导体硅材料股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司根据实际情况，制定了《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	活期存款	933,183.66
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	活期存款	1,841,486.35
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	活期存款	43,151,608.75
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	活期存款	38,696,234.23
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	活期存款	73,946,682.05
合计			158,569,195.04

本公司根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采取专户存储管理，开设募集资金专户，并于 2022 年 11 月 1 日与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户的监管银行中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 11 月 1 日，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户的监管银行上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司(及子公司)、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实执行。

有研半导体硅材料股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2024 年度本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

本公司 2024 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

于 2024 年 10 月 28 日，本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 800,000,000.00 元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-050)。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，未到期部分情况如下：

单位：人民币元

签约银行	产品名称	收益类型	余额	起止日期	是否赎回
中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	浮动收益	150,000,000.00	2024.12.28-2025.03.31	否
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	浮动收益	300,000,000.00	2024.12.31-2025.03.26	否
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	结构性存款	浮动收益	100,000,000.00	2024.12.31-2025.03.26	否
合计			550,000,000.00		

有研半导体硅材料股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

于 2024 年 3 月 27 日，本公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 190,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 28.62%。具体内容详见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-016)。截至 2024 年 7 月 4 日止，本公司已将人民币 190,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金。

本公司 2024 年度不存在超募资金用于归还银行贷款情况。

6. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司 2024 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7. 节余募集资金使用情况

本公司 2024 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8. 募集资金使用的其他情况

(1)超募资金用于股份回购

于 2024 年 2 月 20 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 30,000,000.00 元，不超过人民币 60,000,000.00 元(含)。具体内容详见本公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-007)。

有研半导体硅材料股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

8. 募集资金使用的其他情况(续)

(1) 超募资金用于股份回购(续)

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司本次股份回购计划已实施完毕。本公司累计回购股份 3,555,336 股，占本公司总股本的比例为 0.28%，支付总金额为 35,931,966.48 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于回购完成暨回购实施结果的公告》(公告编号：2024-026)。

(2) 部分募投项目延期

于 2024 年 4 月 25 日，本公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意本公司将募集资金投资项目“集成电路用 8 英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-023)。

四、变更募投项目的资金使用情况

1. 变更募集资金投资项目情况

本公司 2024 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

2. 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2024 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司 2024 年度已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构中信证券股份有限公司作为本公司首次公开发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，出具《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》结论性意见如下：

经核查，保荐机构认为：2024 年度有研硅对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，本公司 2024 年度不存在募集资金投向变更的情况；具体情况与已披露情况一致，未发现首次公开发行股票募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利益的情形。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司 2024 年度不存在两次以上融资的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025 年 3 月 27 日





有研半导体硅材料股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额(注 1)				1,663,967,265.37				本年度投入募集资金总额				527,372,766.60	
变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额				1,000,563,619.63	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注 3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充研发与运营资金	无	257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	66,116,556.21	180,980,031.19	(76,848,068.81)	70.19	不适用	不适用	不适用	否	
集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	无	384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00	144,689,213.68	253,551,681.92	(131,272,618.08)	65.89	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	无	357,347,600.00	357,347,600.00	357,347,600.00	90,631,309.12	145,096,218.93	(212,251,381.07)	40.60	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	301,437,079.01	579,627,932.04	(420,372,067.96)	57.96	—	—	—	—	
超募资金永久补流(注 2)	无	不适用	385,000,000.00	385,000,000.00	190,000,000.00	385,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
股份回购(注 2)	无	不适用	35,935,687.59	35,935,687.59	35,935,687.59	35,935,687.59	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	1,000,000,000.00	1,420,935,687.59	1,420,935,687.59	527,372,766.60	1,000,563,619.63	(420,372,067.96)	70.42	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)(注 4)					详见“三、8 募集资金使用的其他情况(2)”及注 4								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、4 对闲置募集资金进行现金管理情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、5 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”								
募集资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况								
募集资金其他使用情况					详见“三、8 募集资金使用的其他情况”								

有研半导体硅材料股份公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

注 1: “募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元。

注 2: 截至 2024 年 12 月 31 日止, 超募资金总额 663,967,265.37 元, 其中 385,000,000.00 元用于永久补流, 35,935,687.59 元(含印花税、交易佣金等交易费用)用于股份回购。

注 3: 由于本公司未承诺截至期末投入金额, 此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 4: 未达到计划进度主要基于以下因素: 第一, 受市场需求变动的影响, 本公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化, 使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异。第二, 本着控制成本、提高募集资金使用效率的原则, 本公司适当调整了投资节奏。“集成电路用 8 英寸硅片扩产项目”分两个阶段执行, 目前第一阶段 5 万片/月的产能已经建设完毕, 本公司 8 英寸硅片产能已达到 18 万片/月, 且保持了较高的产能利用率; 同时, 第二阶段建设已经启动。“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响, 开工较预期延迟。